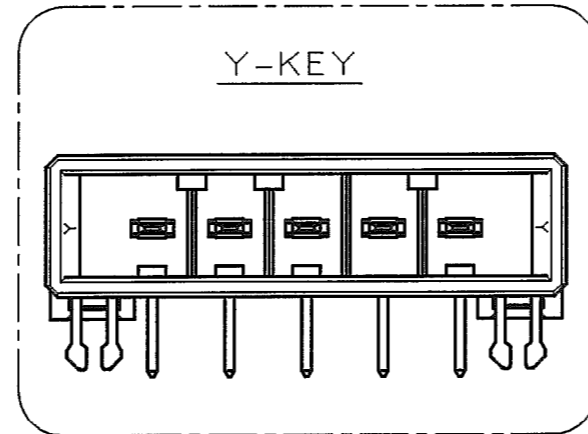
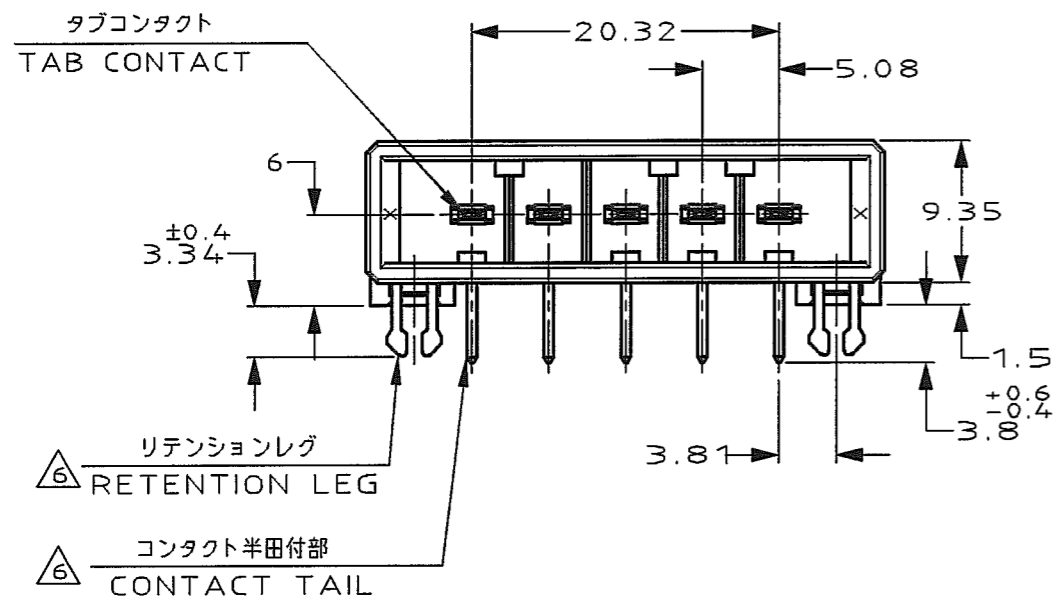
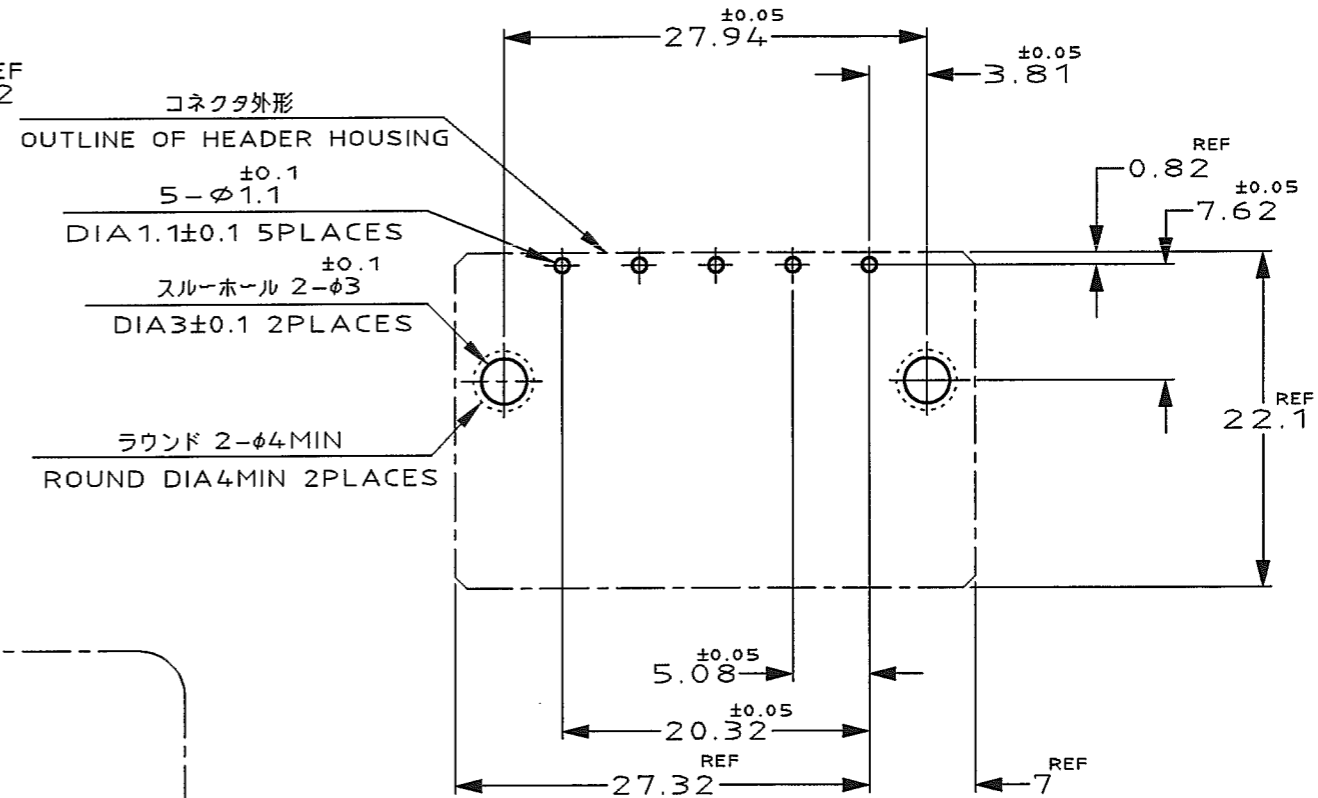
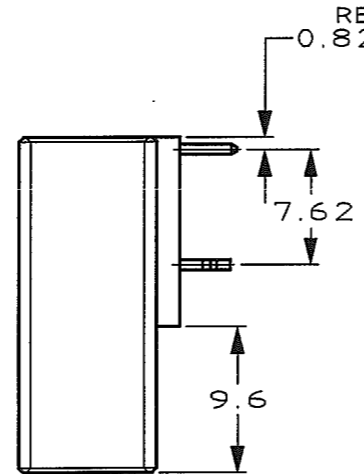
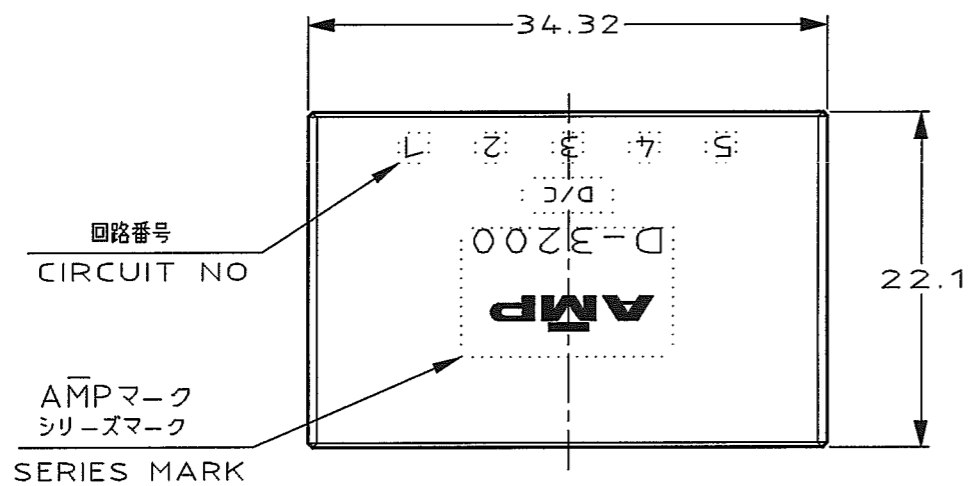


NUMBER 316130  
 3rd ANGLE PROJECTION  
 METRIC



推奨基板取付け穴寸法  
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ 2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ 3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ 4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- ~~△ 5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
- △ 6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- △ 2. めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △ 3. めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △ 4. めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- ~~△ 5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上に半田めっき~~
- △ 6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 : ニッケル下地の上にスズめっき

△ 6	△ 4	2-316130-5	Y
△ 6	△ 3	2-316130-3	Y
△ 6	△ 2	2-316130-2	Y
△ 6	△ 4	1-316130-5	X
△ 6	△ 3	1-316130-3	X
△ 6	△ 2	1-316130-2	X
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY

B	REVISED (FJD0-0039-03)	T S S h	25 APR '93
A	REVISED (FJD0-0114-03)	T S S M	31 JUL '93
0	RELEASED (FJ00-2557-95)	K I Y I	31 JUL '93
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DATE

Copyright © 1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
WIRE RANGE mm (AWG - )	INSULATION DIA mmφ
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 26/JUL/95 K. IKEDA	DE. 26/JUL/95 K. IKEDA
CHK. 31 JUL 95 Y. ISHIKAWA	APP. 31 JUL 95 S. MANABE

NAME 5 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
100F : ±0.2 1000F 300F : ±0.3 3000F 1000F : ±0.4 再 査 : ±3'	A3	J	C= 316130
SCALE	REV.	SHEET	
2-1	B	1 OF 1	